

工程训练（电子工艺实习）  
——电子封装设计（预习题）

一、单选题

1、是否了解本次课程所要学习的内容

~~A:已经明白本次课程内容~~

B:还没弄明白

2、本次实验所做 LED 类型是什么？

A:垂直 LED

B:平面封装 LED

~~C:贴片封装 LED~~

D:其他类型 LED

3、此设备为本次实验的什么设备？



A:扩晶机

~~B:固晶机~~

C:焊线机

D:点胶机

4、此设备为本次实验的什么设备？



A:扩晶机

B:固晶机

~~C:焊线机~~

D:点胶机

5、引线键合采用的是什么工艺？

A:热压键合

B:超声键合

C:压力键合

~~D:热超声键合~~

二、多选题

1、固晶过程中“三点一线”指的是哪些点？

~~A:晶片台十字光标中心点~~

~~B:吸嘴孔中心点~~

~~C:顶针中心点~~

**D:**点胶头中心点

## 2、点胶的作用？

~~A:~~器件内部固定芯片与基板，增强器件的可靠性

**B:**用金属丝将芯片的 I/O 端与对应的封装引脚或者基板上布线焊区互连

~~C:~~利用特定的材料将芯片和焊线保护起来

~~D:~~采用胶体把芯片/晶圆与基板固定，形成热/电通路，为后面的引线键合提供支撑的工艺

## 三：主观题

简述一下 SMD-LED 的主要封装流程？